

0.5mm Pitch

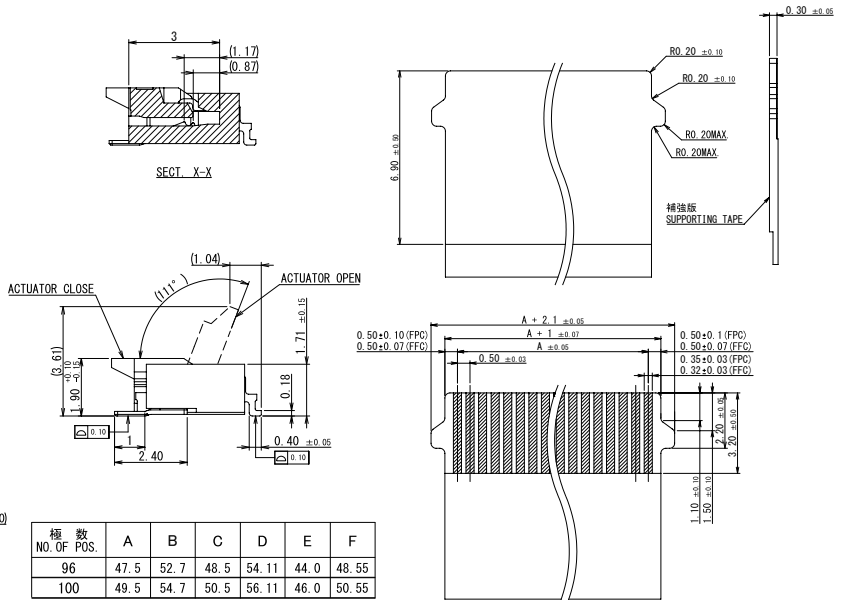
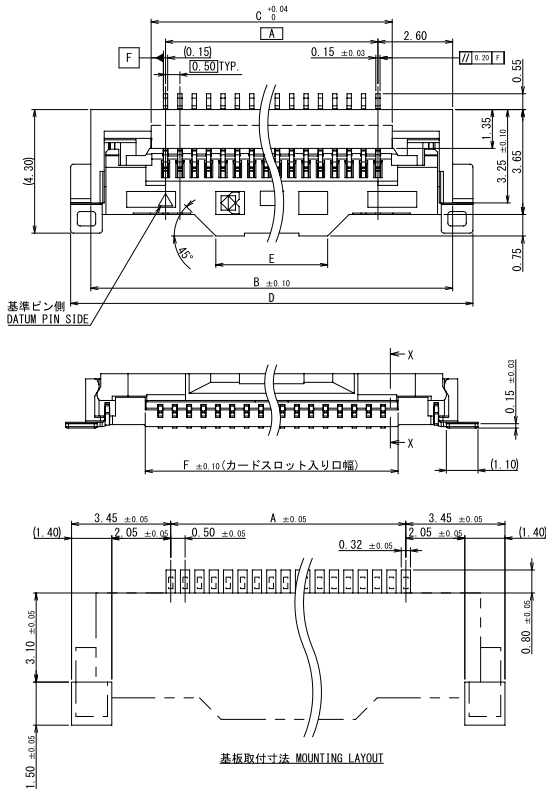
SERIES

6815

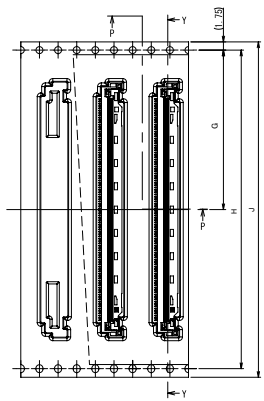
0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック

0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock

高速伝送対応
For High-speed Transmission

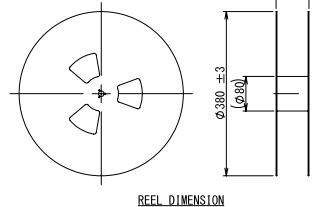
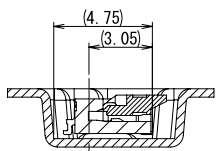


適用FPC/FFC寸法 APPLICABLE FPC/FFC



極数 NO. OF POS.	G	H	J	K
96	34.25	68.4	72.0	78.4
100	34.25	68.4	72.0	78.4

SECT. Y-Y



FPC構成 FPC STRUCTURE

(推奨仕様)

カバーフィルム(材質:ポリイミド)
COVER FILM(MATERIAL: POLYIMIDE)

熱硬化性接着剤
(THERMOSETTING ADHESIVE)

表面処理 PLATING	仕様 SPECIFICATION
金メッキ Au PLATING	Ni UNDER COAT : 3±2μm Au : 0.05μm ~ 0.2μm

導体(材質:圧延銅 t=35μm)
CONDUCTOR
MATERIAL: ROLLED COPPER t=35μm

ベースフィルム(材質:ポリイミド)
BASE FILM(MATERIAL: POLYIMIDE)

裏打板(材質:ポリイミド)
SUPPORTING TAPE(MATERIAL: POLYIMIDE)

断線防止のためカバーフィルムと補強板の
オーバーラップ量は1mm以上とすることを推奨します。
IN ORDER TO PREVENT OPEN CIRCUIT, 1mm OR MORE
OF THE COVER FILM AND THE SUPPORTING PLATE
SHALL BE OVERLAPPED.

FFC構成 FFC STRUCTURE

(推奨仕様)

カバーフィルム(材質:ポリエステル)
COVER FILM(MATERIAL: POLYESTER)

熱硬化性ポリエステル接着剤
(ADHESIVE)

表面処理 PLATING	仕様 SPECIFICATION
金メッキ Au PLATING	Ni UNDER COAT : 0.5μmMIN. Au : 0.05μm ~ 0.2μm

導体(材質:圧延銅 t=35μm)
CONDUCTOR
MATERIAL: ROLLED COPPER t=35μm

ベースフィルム(材質:ポリエステル)
BASE FILM(MATERIAL: POLYESTER)

裏打板(材質:ポリエステル)
SUPPORTING TAPE(MATERIAL: POLYESTER)

断線防止のためカバーフィルムと補強板の
オーバーラップ量は1mm以上とすることを推奨します。
IN ORDER TO PREVENT OPEN CIRCUIT, 1mm OR MORE
OF THE COVER FILM AND THE SUPPORTING PLATE
SHALL BE OVERLAPPED.

注文コード ORDERING CODE

04 6815 XXX 110 846+

極数
NUMBER OF POSITIONS
096 : 96pos.
100 : 100pos.

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Free feel to contact our sales department for available number of positions.

梱包数量 3000個/リール
PACKING QUANTITY : 3000/Reel